

(由本局填寫)

承辦人代碼：
大 類：
I P C 分類：

A6
B6

本案已向：
美國（地區） 申請專利，申請日期： 案號：U.S.S.N.，☒有 ☐無主張優先權

October 31, 2001 10/004, 022

有關微生物已寄存於：，寄存日期：，寄存號碼：

（請先閱讀背面之注意事項，再填寫本頁各欄）

裝 訂 線

五、發明說明(1)

先前技術

本發明為關於鞋類，且更特別的為鞋類結構及符合鞋類結構的製造方法。

這是鞋類結構發展不間斷的成果，在提供美學訴求的同時，降低的價格提供已改善之安慰感。一種常見的結構，一隻鞋子提供沿著腳徹底包裹的鞋面材料，且一種附著在鞋子底部的鞋底材料有兩個明顯不同的部份，一個位在腳後跟區，和一個在前腳區。鞋面材料在鞋下方足弓區明顯包裹，提供獨特的美學訴求。一種皮製鞋內軟墊固定在全部前腳及腳後跟部份上方，且提供鞋底一些堅硬及支撐層。這些先前的結構說明於第一至三圖。先前設計的鞋子(200)包含一纏繞的鞋面(202)及兩片式鞋底(204)。鞋底(204)包含腳後跟區(222)及前腳區(224)，其在鞋背區分隔來揭示纏繞的鞋面(202)。如所示，鞋面(202)包含多片皮革其縫合在一起來形成圍住全腳的外殼。鞋面(202)包含鞋面皮部份(208)其包裹整個前腳區，且沿著接近鞋底中央縱向延伸的縫(210)縫合在一起。鞋面(202)亦包含一或兩片包裹腳後跟區的材料(212)。後跟區部份(212)沿有角度，但不接近垂直，縫(214)，縫合至鞋面皮部份(208)。若兩腳後跟材料包含於結構中，他們可能沿著接近鞋底中央縱向延伸的縫(未顯示)(其躲藏於鞋底(204)腳後跟部份(222))與另一部份縫合在一起，且接著沿鞋後部(其躲藏於腳後跟支持物(216))起來。鞋面(202)亦包含沿著鞋舌開口(220)縫合的鞋帶孔(218)。皮製鞋底(226)固定於鞋內。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

後

五、發明說明(2)

雖然提供需要的美學，此常見的結構遭受許多缺點。第一此結構需要一個延伸全部鞋子的大前面皮。鞋面皮部份需要大到能從鞋子中央底部一邊沿鞋子頂端且下來至鞋子中央底部另一邊延伸。此可以顯著的增加材料成本，特別是當鞋面由高級皮革製成。第二，鞋子包含腳後跟部份，其沿著垂直縫合處與鞋面皮部份結合。在同時，鞋面皮部份沿足部及前腳區完全包裹，僅沿著鞋子中央底部有接縫。對應的，足弓部與前腳區的鞋面形式由打樣的鞋面皮部份最後的變形大大製成。其可能導致多處不需要的皮革縫合，其可能弄皺，突起或將材料弄變形。第三，皮製鞋內軟墊不提供支撐及穩定某些活動需要的層。

內容

本發明克服上述問題，其中“纏繞”鞋面及分隔腳後跟及前腳鞋底部份的鞋子結構為沿水平接縫上下結合被提供。水平接縫最好位在鞋底稍微上方的位置，且最好適合平行延伸至腳部底線。

一個具體實施例，水平接縫包含向外翻轉 moc 縫合至前腳及腳後跟區，且一個向內翻轉的地方縫合至足弓區。上部及底部最好沿著前腳及腳後跟縫合邊緣接合已增加黏合且阻擋縫合結構分層。

一個更加^①的具體實施例，鞋底包含分隔前腳及腳後跟區，及固定在鞋底前腳及腳後跟區底架橋上部頂上內的鑄模型成的鞋內軟墊。鑄模型成的鞋內軟墊延伸過腳後跟及足弓

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明(3)

區中止於與腳球狀部排列的前腳區。當允許前腳需要的彎曲時，此提供腳後跟及足弓區需要的穩定度。

本發明亦提供鞋類物件的製造方法。方法一般包含下列步驟(1)製造多片鞋面，(2)由水平延伸的邊緣縫合鞋面片，(3)小腿部份接合一至底部皮革，(4)沿水平接縫縫合底部皮革至鞋面，(5)鞋面及鞋底皮革配件打樣，(6)鞋面及鞋底皮革配件製模，(7)從分隔前腳及腳後跟區處製作一個鞋子外底，及(8)安裝鑄模型成的鞋內底及鞋墊於鞋面內。水平接縫最好由在前腳及腳後跟區的縫合處，及在足弓區的內部縫合處形成。

本發明提供鞋子物件，當製作相似設計一般的結構增加舒適及降低成本時其提供一個需要的美學觀點。水平接縫允許鞋面由小片材料製作，特別是當鞋面是由皮革製成時，其可以顯著降低材料成本。水平接縫進一步允許鞋面降低鞋面縫合更接近腳步形狀。其進一步由彎曲的水平接縫增加筆直的腳步底線。使用鞋子外底與分隔的前腳及腳後跟區降低外底材料的需求。如需要提供足弓^和腳後跟區支撐與穩定時，鑄模型成的鞋內軟墊允許鞋子前腳區收縮。

本發明這些與其他目標，優點，及特徵將藉由詳細的具體實施例描述及圖示立即被了解領會。

圖式簡單說明

第一圖為先前物件結構的俯視圖。

第二圖為先前物件結構的側面圖。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明(4)

第三圖為先前物件結構的仰視圖。

第四 A 圖為本發明具體鞋子結構右側面圖。

第四 B 圖為鞋子左側面圖。

第五圖為鞋子俯視圖。

第六圖為鞋子底部平面圖。

第七 A 圖為第五圖沿 7A-7A 線之部份鞋子剖面圖。

第七 B 圖為第五圖沿 7B-7B 線之部份鞋子剖面圖。

第七 C 圖為第五圖沿 7C-7C 線之部份鞋子剖面圖。

第七 D 圖為第五圖沿 7D-7D 線之部份鞋子剖面圖。

第八 A-E 圖為多種鞋面部份平面圖。

第九 A-B 圖鞋底部份平面圖。

實施方法

本發明最佳具體鞋子製作圖為第四圖，且以 (10) 表示。鞋子 (10) 包含鞋面 (12)，鞋底 (14) 及外底 (16)。如第七圖所示，鞋子 (10) 亦包含固定在鞋面 (12) 內的鞋內底 (20) 及鞋墊 (22)。鞋面 (12) 與鞋底 (14) 沿水平接縫 (18) 縫合在一起。鞋外底 (16) 包含以分隔的前腳及腳後跟區 (24) 及 (26)。雖然(北)發明描述為連接運動(後)的鞋子，但本發明適合使用於其他一般範圍的鞋子。在此申請書，“足弓區”一般為鞋子符合穿戴者足部足弓的部份，“前腳區”一般為在鞋子足弓區前符合穿戴者足部前腳（如腳趾）的部份，且“腳後跟區”一般為在鞋子足弓區後符合穿戴者足部腳後跟的部份。前腳區 (30)，足弓區 (32)，及

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(5)

腳後跟區(34)說明於第四圖。

如上所述，鞋面(12)與鞋底(14)共同定義為鞋子(10)包含腳步的外殼。雖然鞋面(12)將由申請書中多樣明顯的設計及安排，但鞋面(12)最好包含內部區(100)(見第八B圖)，外部區(102)(見第八A圖)，鞋帶孔(104)(見第八C圖)，後部支持物(106)(見第八D圖)及鞋舌(108)(見第八E圖)。鞋面(12)包含沿其邊緣延伸的邊緣(36)以固定鞋面在(12)至鞋底(14)上如下詳細描述。邊緣(36)在前腳(30)，足弓(32)，及腳後跟(34)區間多樣的寬度提供充分的材料使鞋面(12)縫合至鞋底(14)。如所示，前腳及腳後跟區邊緣(36)寬度足夠容納向外轉換的縫合。足弓邊緣(36)相當窄，僅能提供足夠向內轉換縫合的材料。

鞋底(14)最好包含內部區(112)(見第九A圖)及外部區(114)(見第九B圖)。兩部份(112)及(114)沿鞋子(10)內外側縱向延伸，且沿縱向縫結合在一起，沿鞋底(14)中央延伸。鞋底(14)包含沿周圍延伸的邊緣區(38)來固定鞋底(14)至鞋面(12)。現在提及第四圖，鞋底邊緣(38)，頂鞋面邊緣(36)，在多樣寬度在前腳，足弓脊腳後跟區間。在前腳及腳後跟區邊緣(38)的寬度足夠容納向外轉換的縫合，當足弓區邊緣(38)狹窄時，僅能提供足夠向內轉換縫合的材料。

鞋內底(20)接合於鞋面(12)內至鞋底(14)頂部。鞋內底(20)最好僅延伸鞋子(10)長度的3/4，中止於前

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明(6)

腳區(30)與腳步球狀物排列。鞋內底(20)厚度最好朝向前邊緣逐漸變細。鞋內底(20)形狀最好與腳底表面輪廓吻合，提供一個堅固的平台支撐腳部足弓及腳後跟區。雖然申請書中有多樣穩固的鞋內底(20)，但最好的鞋內底(20)穩固的提供鞋子(10)在腳後跟及足弓區一般承載下的收縮。如結果，鞋內底(20)忽視一般小腿部的需要。鞋內底(20)最好由常見材料製作，如耐龍或其他聚合材料。

鞋墊(22)可移動的固定於鞋面(12)內鞋內底(20)頂部。鞋墊(22)最好延伸整個鞋子(10)全長，且為有上(40)及下(42)層的雙倍密度結構。上層(40)最好由低密度墊狀材料製成。如結果，如在坐，站，或緩和移動時，上層(40)提供彈性且緩和小承載下的衝擊。下層(42)最好由高密度材料製成，如在走，跑，或跳時，提供彈性且緩和重承載下的衝擊。一般鞋墊襯墊(未顯示)最好覆蓋鞋墊(22)上部表面。

如上所述，外底(16)包含前腳部份(24)及腳後跟區(26)。兩外底部份(24)及(26)，從另一個足弓區分隔。其使足弓區的鞋底*14)可被看見以提供需要的美學觀點。第七A至七D圖為剖面圖顯示沿鞋子(10)的多樣區域。前腳部份(24)最好延伸過鞋子(10)前腳區(30)，提供一個穿戴表面嚙合穿戴者足部前腳底。前腳部份(24)底表面最好有彈性以提供以改良的收縮。若需要，前腳部份(24)可包含採，拉或其他改良收縮的材料。前腳部份(24)上表面最好形式符合鞋內底(20)及鞋墊(22)需要的形狀。腳

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(7)

後跟部份(26)最好延伸過鞋子(10)腳後跟區(34)，提供一個穿戴表面嚙合穿戴者足部腳後跟。腳後跟部份(26)底表面最好有彈性以提供以改良的收縮。如前腳部份(24)，腳後跟部份(26)，若需要，可包含採，拉或其他改良收縮的材料。腳後跟部份(26)上表面最好形式符合鞋內底(20)及鞋墊(22)需要的形狀。前腳部份(24)與腳後跟部份(26)最好個別鑄模且由膠結材料或其他常見的黏著劑固定於鞋底(14)。可替換的，前腳部份(24)與腳後跟部份(26)可使用常見的直接依附製模技術與設備鑄模於鞋底位置。

製造與裝配

鞋子(10)常見製造設備製造。多樣片狀鞋面(12)使用常見技術與設備從需要的材料上被切下，如皮革。如上所述，鞋面(12)最好從內部(100)，外部(102)，鞋帶孔(104)，後部支持物(106)及鞋舌(108)裝配，如第八A-E圖所示。鞋面片狀物以常見的方法縫合在一起形成鞋面(12)。舉例，內部(100)由在腳趾區接縫(124)及腳後跟區第二接縫(未顯示)縫合至外部(102)。第二接縫(未顯示)由後部支持物(106)覆蓋。其必須注意，鞋面片狀物被剪下產生邊緣(36)，其功能如同允許沿鞋面(12)配件周圍延伸的縫合處。邊緣(36)由內部(100)，外部(102)，及後部支持物(106)配合。當鞋面(12)與鞋底(14)縫合在一起時，鞋面片狀物被裝配如在水平線後的邊緣(36)(且最好跟隨腳部底線)。洞(62)最好在內部(100)，外部(102)，

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(8)

及後部支持物(106)邊緣(36)內來促進此區域的縫合(52)。鞋底片狀物，名為內部片狀物(112)及外部片狀物(114)，亦使用常見技術與設備從需要的材料上被切下(見第九A-B圖)。鞋底片狀物最好由與鞋面片狀物一樣的材料切下以提供需要的“纏繞”外觀。鞋底片狀物被切下形成水平接縫，且提供材料形成邊緣(38)。鞋底片狀物以常見的方法縫合在一起形成鞋底(14)。在鞋底片狀物間的縫(50)最好由鞋子(10)中央底部縱向延伸。洞(64)可在內鞋底片狀物(112)邊緣(38)內預先產生來來促進此區域的縫合。鞋面(12)與鞋底(14)最好有襯底，且由常見襯裡材料(未顯示)，常見的腳趾護套(未顯示)及其他需要的常見強化物件(未顯示)強化。

鞋內底(20)由堅硬材料製造，最好由耐龍或其他聚合材料。就其言，鞋內底(20)最好從熔化材料注射模型或印模澆鑄，或從薄片原料真空形成。鞋內底(20)可由其他常見的技術及設備選擇鞋內底材料製造。製造鞋內底(20)為使用黏膠或黏著劑黏合至鞋底(14)上表面。

鞋面(12)與鞋底(14)接著使用常見設備接合在一起。如上所述，縫在水平方向延伸且更特別為沿著水平延伸曲線在足部底線區平行移動。因此，“廣泛水平面”及“大致水平面”傾向於有足夠的寬度包含一條平行足部底線延伸的線。如說明，縫曲線稍微向上如期從鞋後朝足弓區延伸。在足弓區，縫有顯著的曲線，跟隨腳部足弓曲線。其必須注意，縫最好跟隨在鞋子中邊較側邊高的足弓，極度像腳部足

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

編

五、發明說明(9)

弓。縫在腳後跟區恢復小曲線。曲線縫促進鞋減形狀符合腳部形狀。鞋面(12)與鞋底(14)由沿邊緣(36)及(38)延伸的外部轉換接縫(52)(或電纜接縫)結合在前腳(30)及腳後跟(34)區。縫(52)如需要,可由手工或機械縫合,最好使用常見縫線。在縫外部轉換區前,一黏合層使用於兩邊緣(36)及(38)間。黏合降低在縫外部轉換區兩邊緣(36)及(38)分離或分層的可能性。鞋面(12)與鞋底(14)使用常見內部轉換縫(54)結合於足弓區(32)。縫(54)如需要,可由手工或機械縫合。

鞋面(12)與鞋底(14)配件接著固定過一常見持續孔(未顯示)。雖然鞋子的形狀主要由鞋面(12)與鞋底(14)片狀物產生,持續孔幫助鞋子(10)成形。鞋面(12)與鞋底(14)配件最好由熱形成以維持其形狀。

鞋墊(22)一般為常見雙倍密度鞋墊,有不同密度共同擴張上(56)及下(58)層。鞋墊(22)由常見的技術及設備製造,最好從EVA,泡沫聚氨基鉀酸酯或其他相似的黏合材料。一種襯裡材料(未顯示)可覆蓋於鞋墊(22)上表面。鞋墊(22)最好可移動嵌入鞋(10)內,但若需要可為“永久”固定。

上述為本發明最佳具體實施例。可以做多樣修正及改變除了背離本發明如申請專利範圍之精神及範圍,說明符合包含相同原理的專利法原則。任何提及的單數申請專利材料,舉例,使用“一種”,“一種”,“此”或“上述”不解釋為限制材料為單數。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

線

五、發明說明(10)

圖示元件簡單說明

10	shoe	鞋
12	upper	鞋面
14	bottom	鞋底
16	outsole	外底
18	horizontal seam	水平接縫
20	insole	鞋內底
22	footbed	鞋墊
24	forefoot portion	前腳區
26	heel portion	腳後跟區
30	forefoot region	前腳區
32	arch region	足弓區
34	heel region	腳後跟區
36	margin	邊緣
38	marginal portion	邊緣區
40	upper layer	上層
42	lower layer	下層
50	seam	縫
52	stitch	縫合
56	upper layer	上層
58	lower layer	下層
62	hole	洞
64	hole	洞

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

五、發明說明(11)

100	inner quarter	內部區
102	outer quarter	外部區
104	eyestay	鞋帶孔
106	backstay	後部支持物
108	tongue	鞋舌
112	inner piece	內部區
112	inner piece	內部片狀物
114	outer piece	外部區
114	outer piece	外部片狀物
124	seam	縫
200	shoe	鞋子
202	upper	鞋面
204	sole	鞋底
208	vamp piece	鞋面皮部份
210	seam	縫
212	material	材料
214	seam	縫
216	backstay	鞋後跟支持物
218	eyestay	鞋帶孔
220	tongue opening	鞋舌開口
222	heel portion	腳後跟區
224	forefoot portion	前腳區
226	leather insole	皮製鞋底

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

四、中文發明摘要(發明之名稱：

鞋類的構造及其製造方法

一種有一條常見水平接縫結合鞋面及鞋底的“纏繞鞋結構。鞋外底包含展開至“傳統鞋面的分隔腳後跟及前腳區。水平接縫最好平行延伸至腳部底線。水平接縫包含在前腳及腳後跟區向外翻轉縫合處，及在足弓區向內翻轉縫合處。包發明亦提供鞋類物件製造方法包含步驟(1)形成鞋面，(2)形成鞋底，(3)沿水平接縫縫合鞋底至鞋面，(5)鞋面及鞋底配件打樣，(6)鞋面及鞋底配件製模，(7)從分隔的前腳及腳後跟部份形成鞋外底，及(8)在鞋內安裝鑄模的鞋內底與鞋墊。

英文發明摘要(發明之名稱：

FOOTWEAR
CONSTRUCTION AND
METHOD FOR
MANUFACTURING SAME

A “wrap-around” shoe construction having a generally horizontal seam that joins the upper and bottom. The sole includes separate heel and forefoot sole portions that expose the “wrap-around” upper. The horizontal seam preferably extends substantially parallel to the bottom line of the foot. The horizontal seam includes an outwardly-turned moc stitch in the forefoot and heel regions, and a inwardly turned butt stitch in the arch region. The present invention also provides a method for manufacturing an article of footwear including the steps of (1) forming the upper, (2) forming the bottom, (3) stitching the bottom to the upper along a horizontal seam, (5) lasting the upper and bottom assembly, (6) setting the shape of upper and bottom assembly, (7) forming the outsole from separate forefoot and heel portion, and (8) installing molded insole and a footbed in the shoe.

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁各欄)

裝

訂

線

陸、(一)、本案指定代表圖爲：第 7A 圖

(二)、本代表圖之元件代表符號簡單說明：

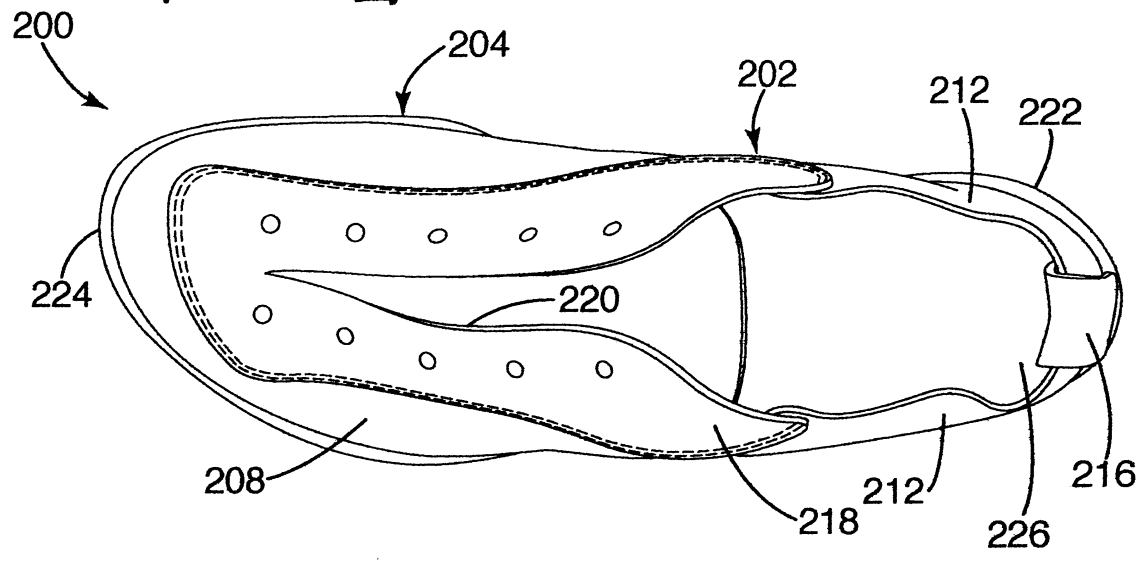
10	shoe	鞋
12	upper	鞋面
14	bottom	鞋底
20	insole	鞋內底
22	footbed	鞋墊
24	forefoot portion	前腳區
26	heel portion	腳後跟區
36	margin	邊緣
38	marginal portion	邊緣區
40	upper layer	上層
42	lower layer	下層
106	backstay	後部支持物

柒、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：

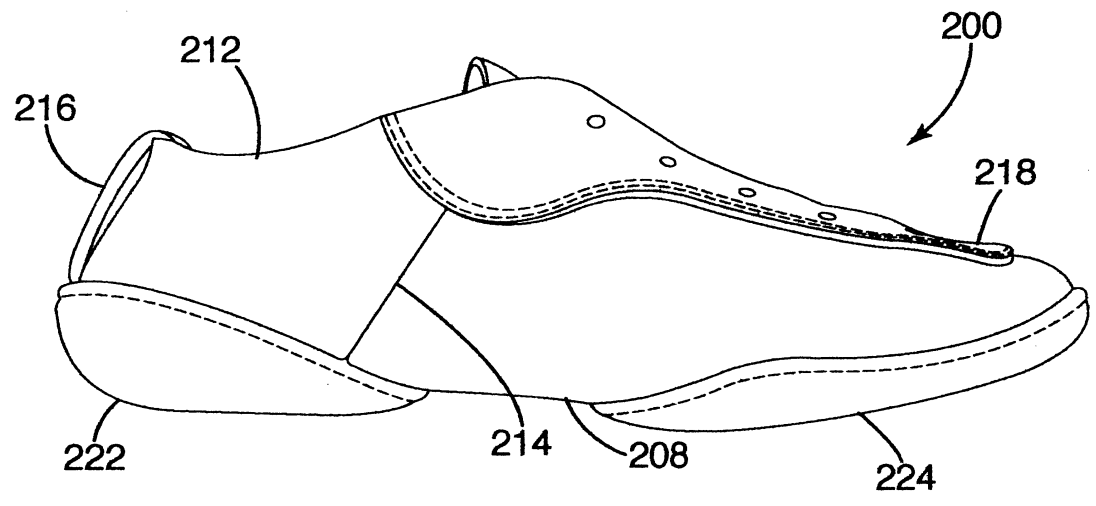
91115773

Photo/0011

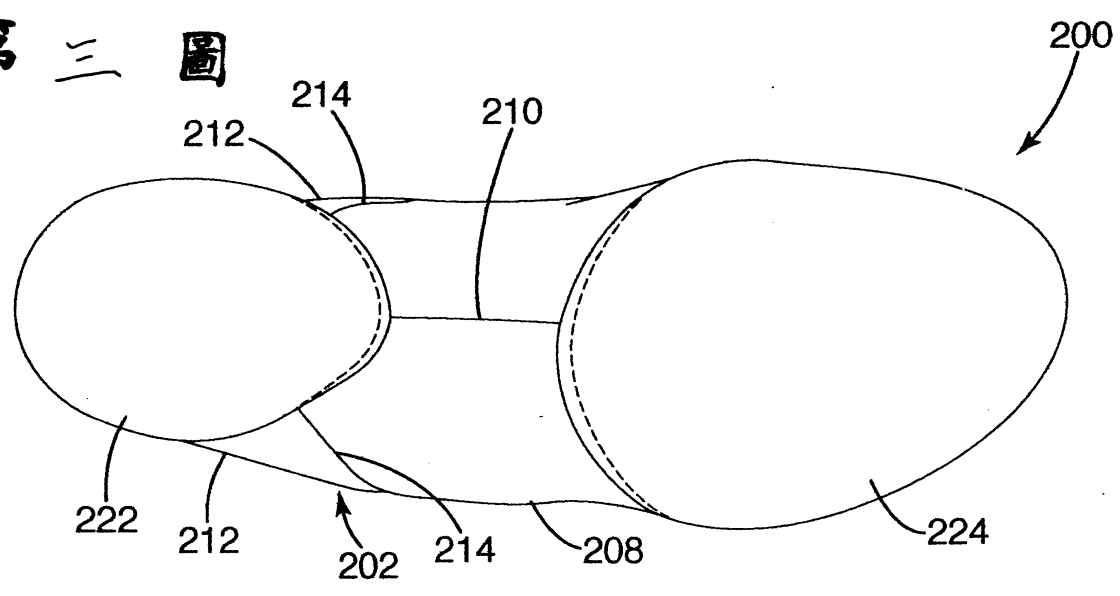
第一圖

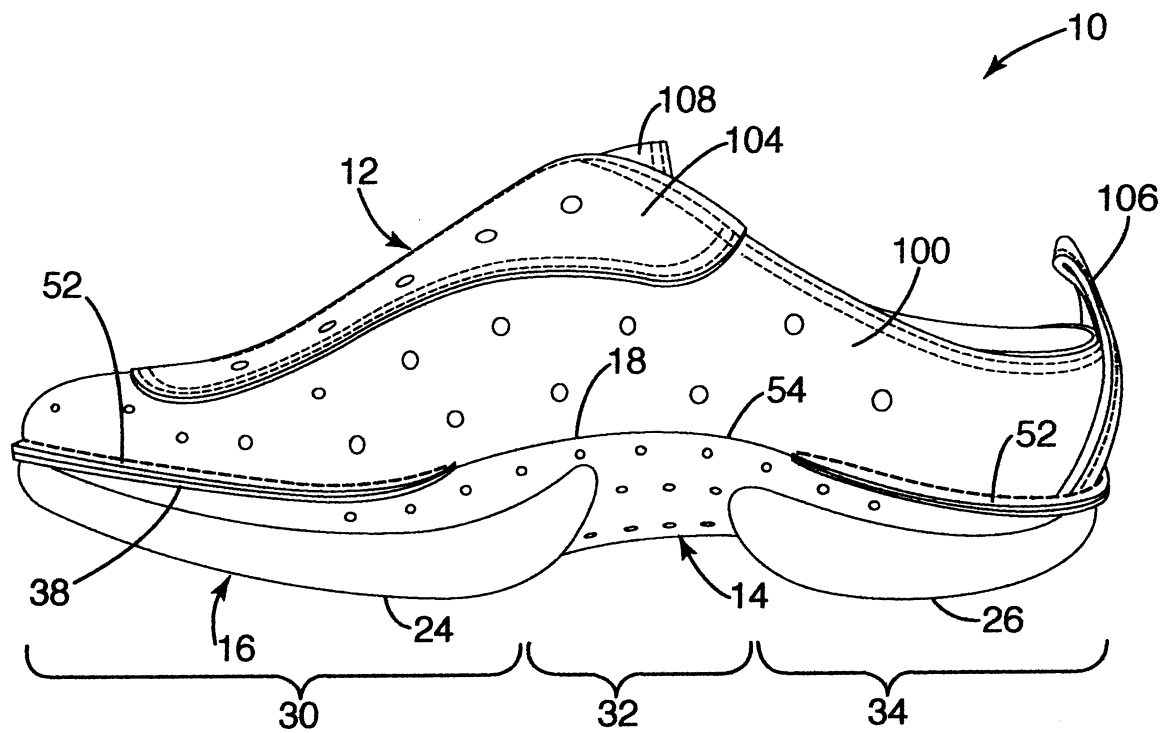


第二圖

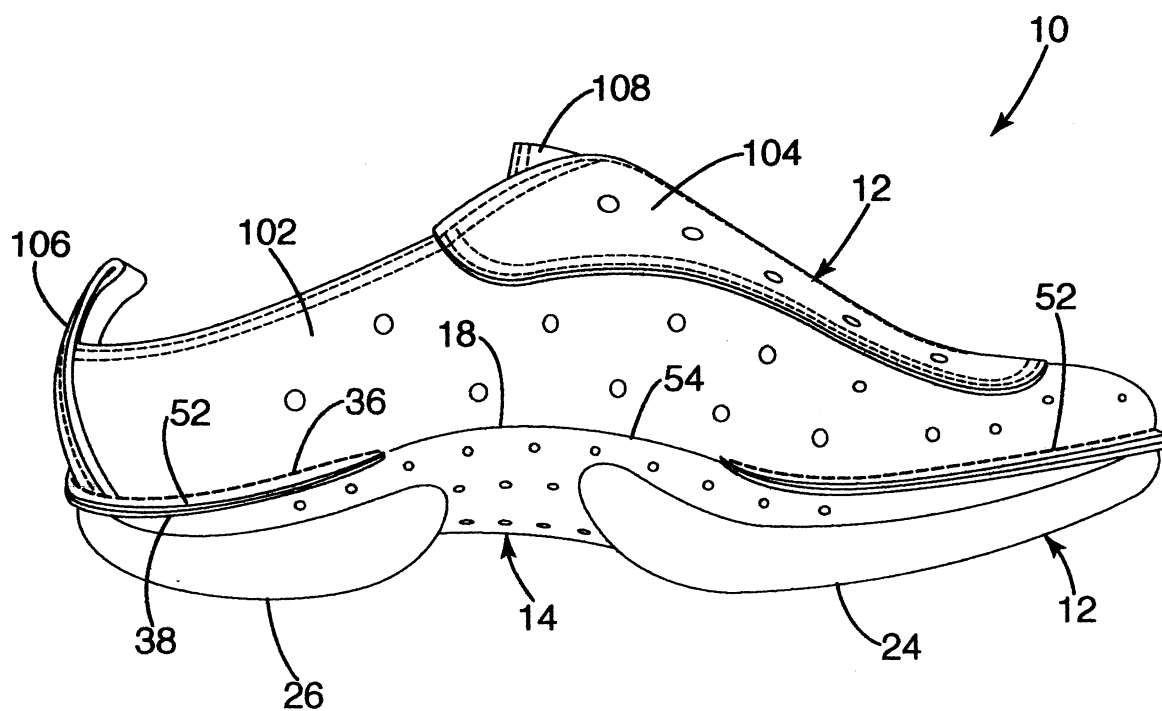


第三圖

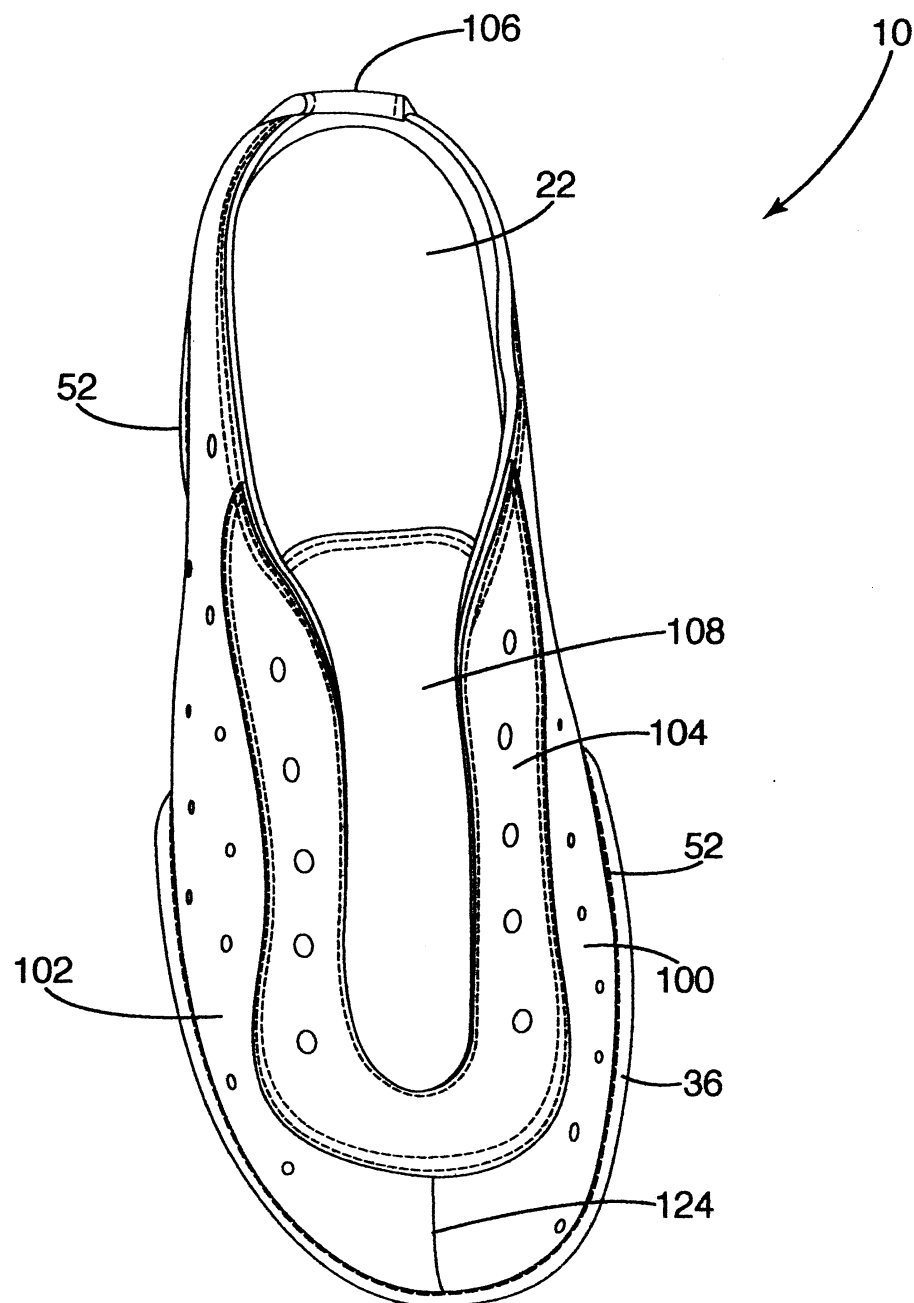




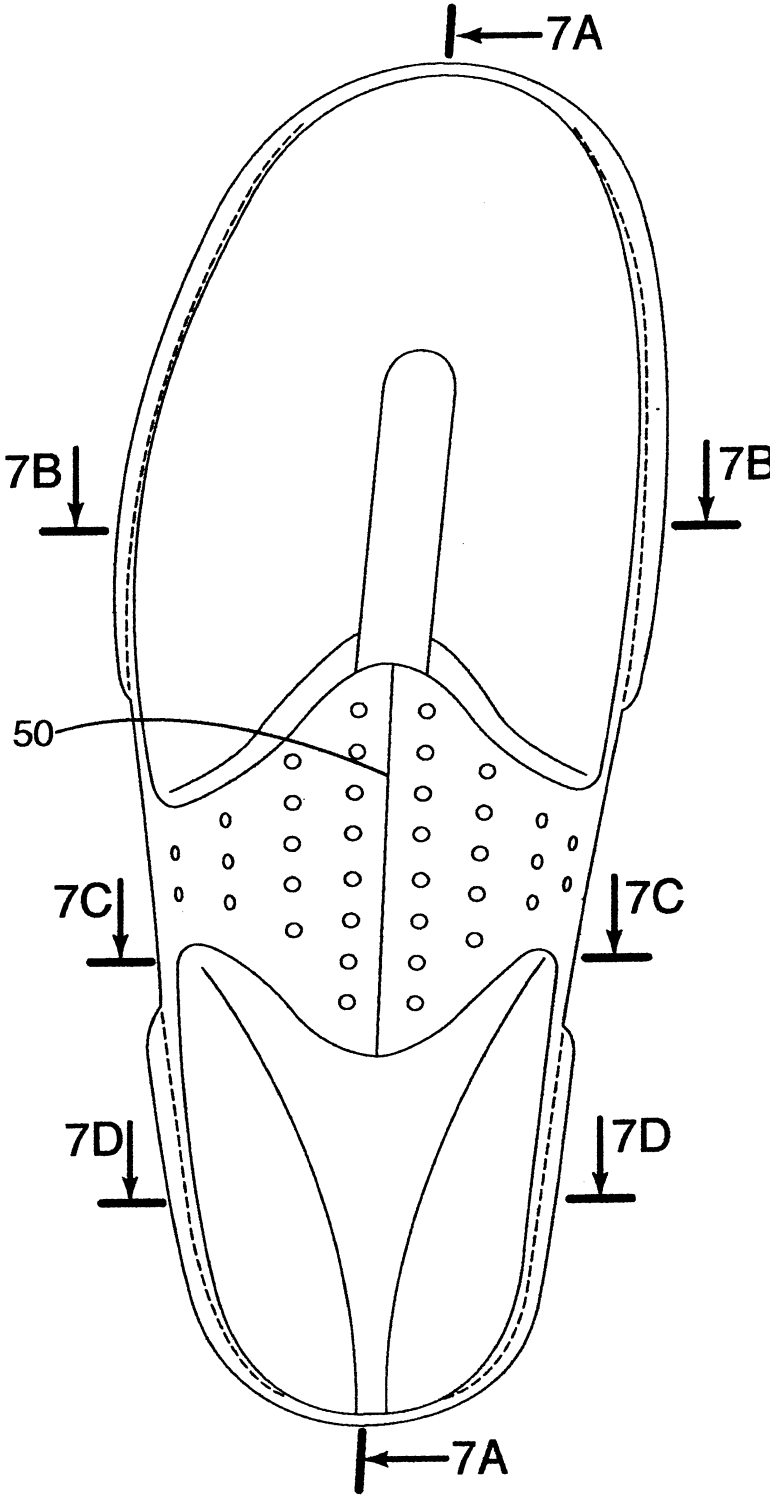
第四 A 圖



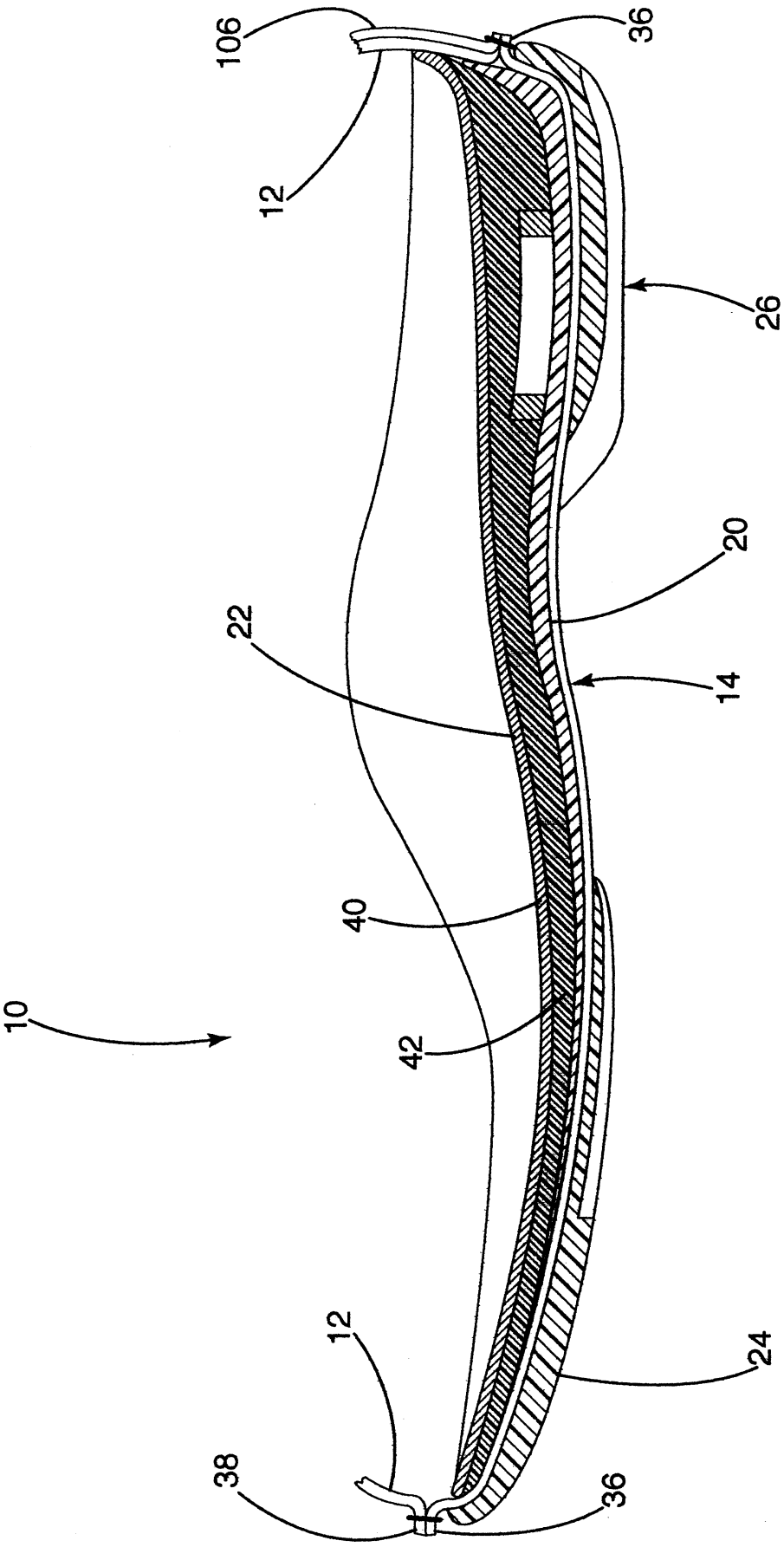
第四B圖



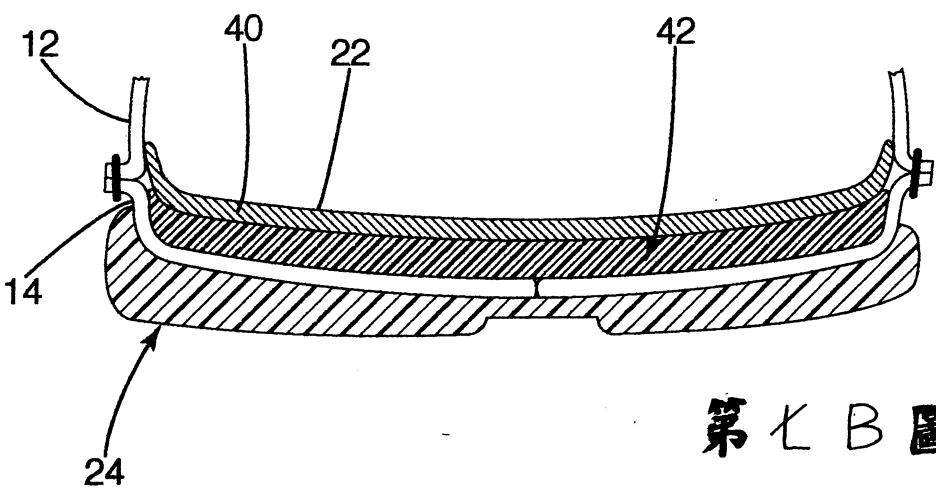
第五圖



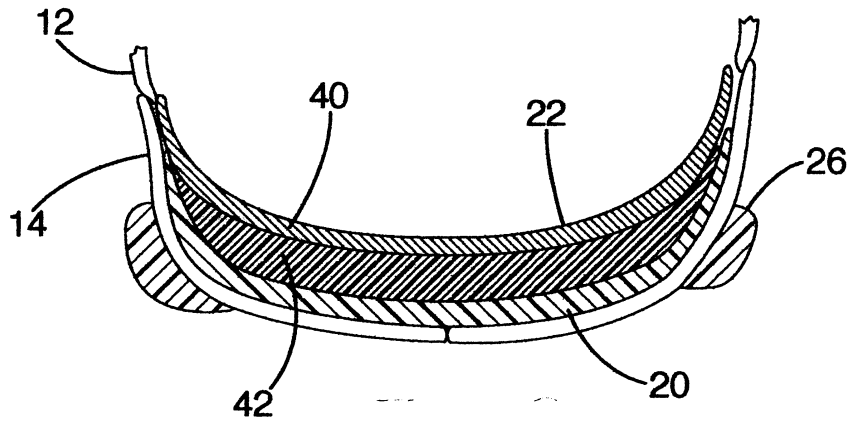
第六圖



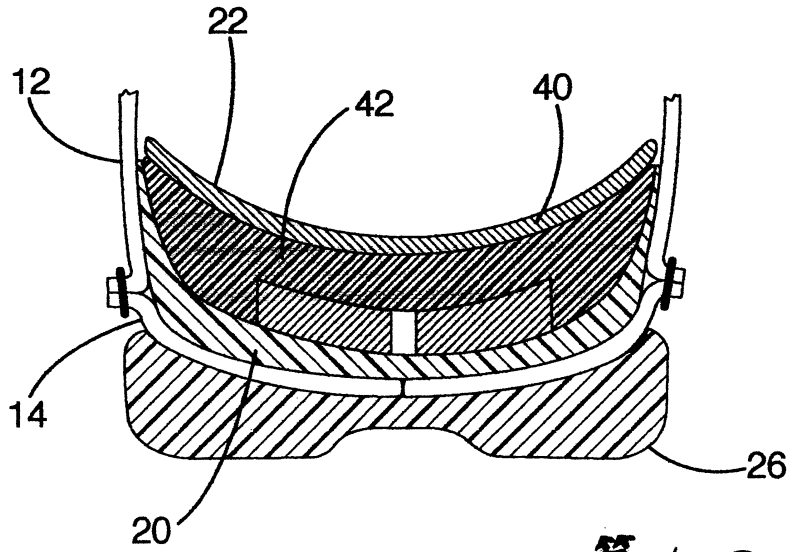
第七A圖



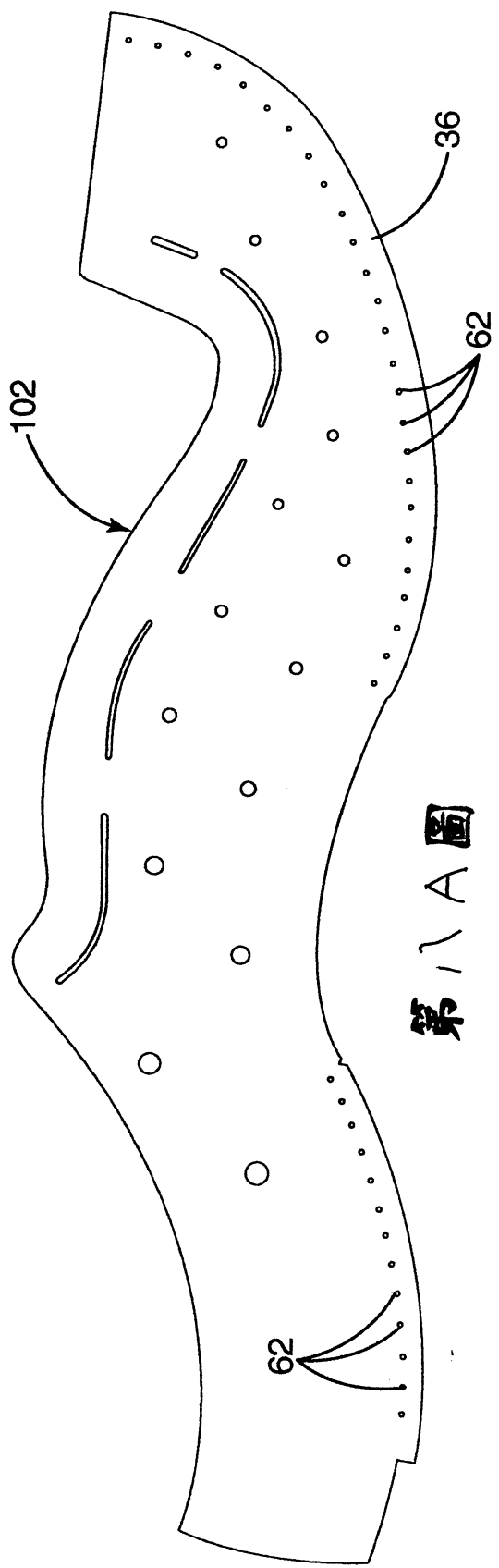
第七B圖



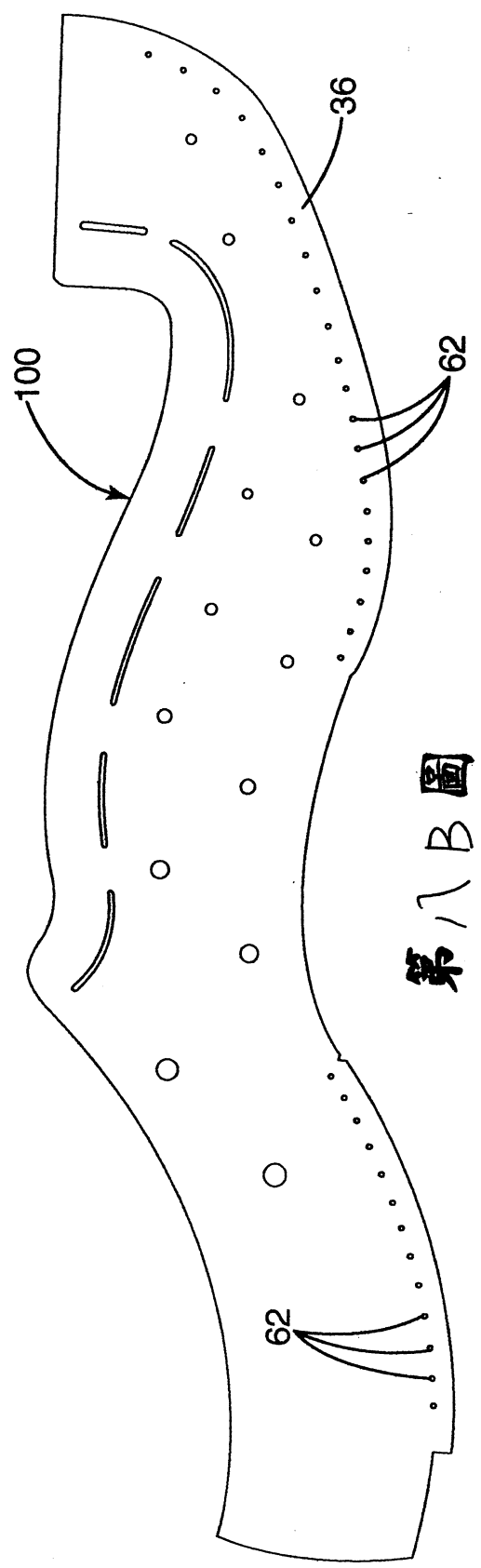
第七C圖



第七D圖

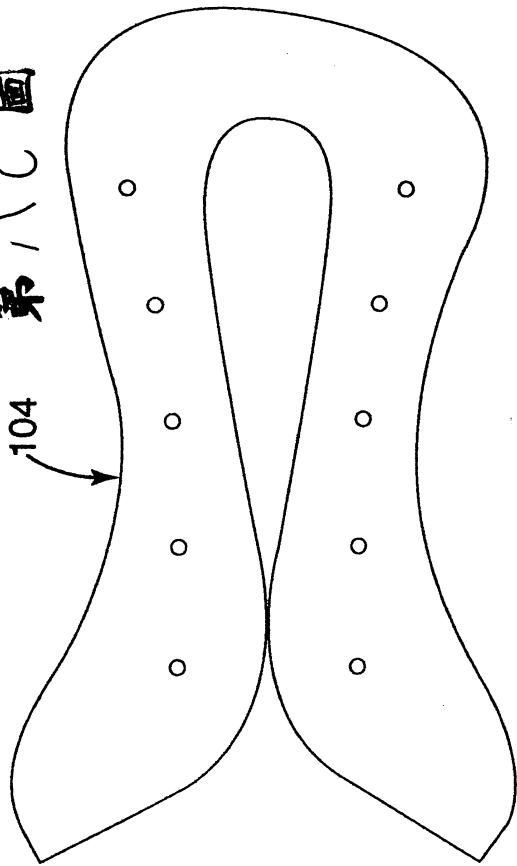


第八A圖

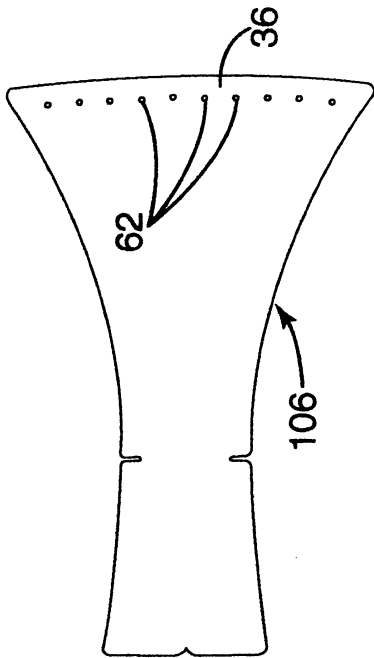


第八B圖

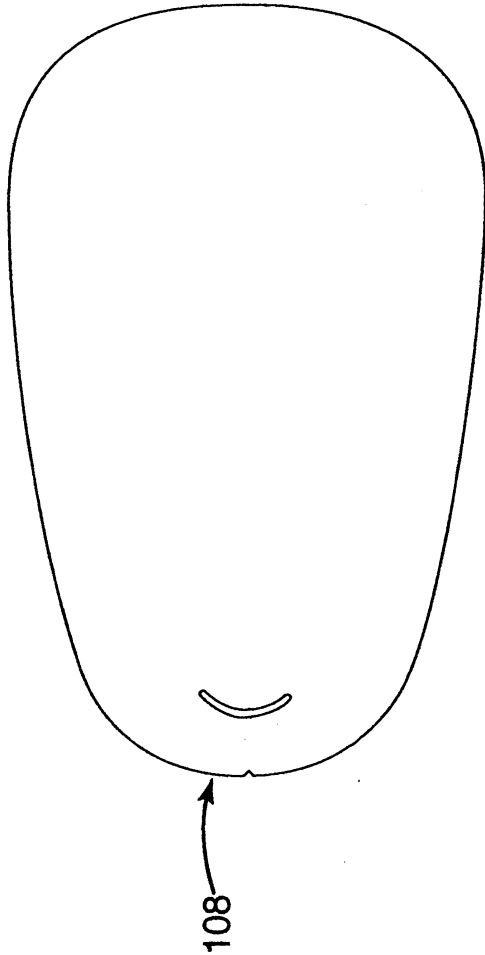
第八C圖

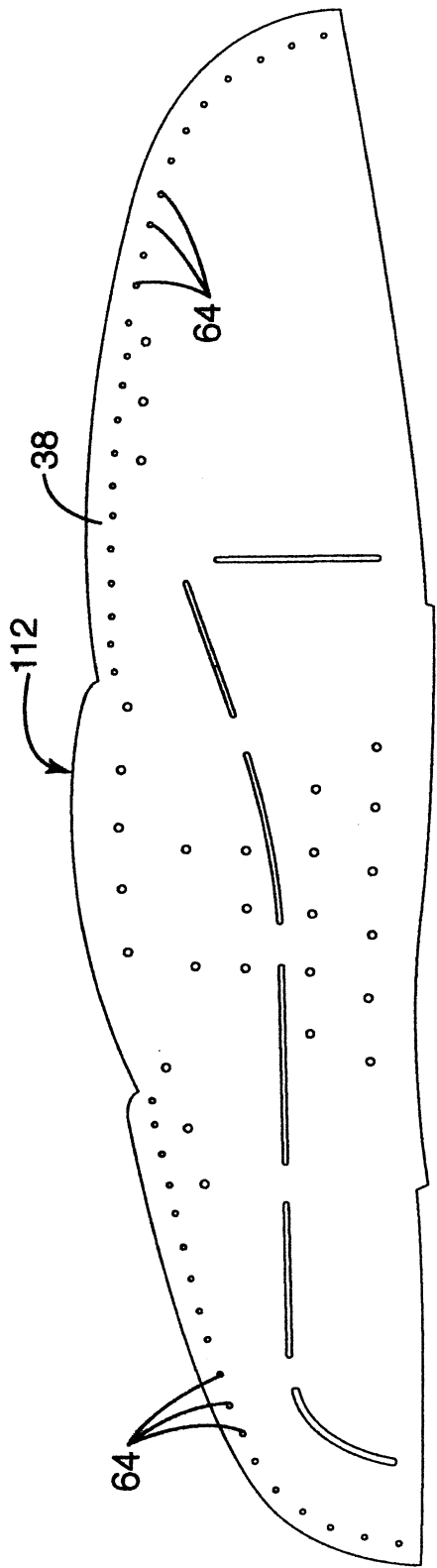


第八D圖

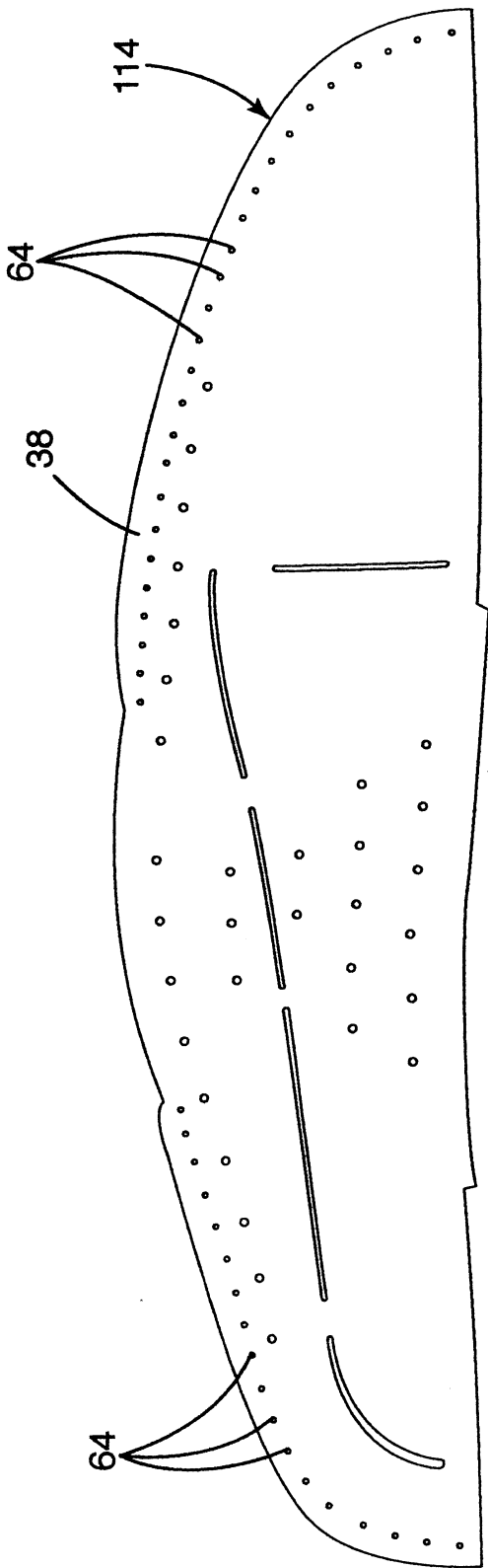


第八E圖





第九 A 圖



第九 B 圖

公告本

申請日期	91. 7. 16
案 號	91115773
類 別	A43B 9/02

(以上各欄由本局填註)

A4

C4

修正 92.10.15
本 年 月 日
補充

發明專利說明書 I224497

一、發明 名稱	中 文	鞋類的構造及其製造方法
	英 文	FOODWEAR CONSTRUCTION AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME
二、發明 創作人	姓 名	(1) 梅森·貝里 Manon Belley (2) 杜恩·N·雷伊 Tuan Nguyen Le (3) 葛蘭特·尤瑞 Grant Urie
	國 籍	(1) 加拿大 (2) 美國 (3) 美國
	住、居所	(1) 加拿大魁北克省 H7P 5W1 拉瓦爾市 (2) 美國俄勒岡州 97225 波特蘭市 (3) 美國佛蒙特州 05482 雪伯尼市
三、申請人	姓 名 (名稱)	美商·渥弗林國際有限公司 Wolverine World Wide, Inc.
	國 籍	美國 US
	住、居所 (事務所)	美國密西根州 49351 洛克福市寇特蘭路 9341 號
	代 表 人 姓 名	羅倫斯·C·保森

六、申請專利範圍

1. 一種鞋類物件，其包含：

一具有縫合處的鞋面；

一具有縫合處的鞋底，有縫合處的鞋面沿水平延伸的接縫縫合至縫合處的鞋底；且

鞋外底分隔腳後跟及前腳區，腳後跟及前腳區從另一個延伸至少部份鞋子足弓區鞋底分隔，其中該接縫位於腳後跟區與前腳區的上方且與此二區分隔開來。

2. 如申請專利範圍第 1 項之鞋類物件，其中接縫包含在腳後跟及前腳區向外翻轉縫合處，接縫進一步包含在足弓區向內翻轉接縫。

3. 如申請專利範圍第 2 項之鞋類物件，其中進一步包含一黏著劑沿向外翻轉縫合處固定鞋面縫合處及鞋底縫合處。

4. 如申請專利範圍第 3 項之鞋類物件，其中進一步包含一種鞋內底，鞋內底固定於鞋底，且延伸過腳後跟區及足弓區提供腳後跟區及足弓區需要的硬度。

5. 如申請專利範圍第 4 項之鞋類物件，其中鞋內底由聚合物材料製成。

6. 如申請專利範圍第 5 項之鞋類物件，其中進一步包含位在鞋內底上方的鞋墊，鞋墊由有彈性的材料製成提供鞋類物件需要的緩衝力。

7. 如申請專利範圍第 6 項之鞋類物件，其中鞋墊可移動的固定於鞋內底上。

8. 如申請專利範圍第 2 項之鞋類物件，其中接縫平行穿戴者腳部底線延伸。

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

線

六、申請專利範圍

9. 一種鞋類物件，其包含：

一具有沿其周圍延伸邊緣的鞋面；

一具有沿其周圍延伸邊緣的鞋底；

一個接縫在鞋面邊緣與鞋底邊緣結合鞋面及鞋底，接縫水平延伸，接縫包含至少延伸前腳及腳後跟區向外翻轉縫合處；且

鞋外底有腳後跟及前腳部份，腳後跟部份在足弓區與前腳區分隔，藉以鞋底至少延伸至足弓區，其中該接縫實質位於腳後跟區與前腳區的上方且與此二區分隔開來。

10. 如申請專利範圍第 9 項之鞋類物件，其中進一步包含一黏著劑沿向外翻轉縫合處固定鞋面邊緣及鞋底邊緣。

11. 如申請專利範圍第 10 項之鞋類物件，其中接縫包含延伸過前腳及腳後跟區之向外翻轉縫合處。

12. 如申請專利範圍第 11 項之鞋類物件，其中接縫包含在足弓區向內翻轉接縫。

13. 如申請專利範圍第 12 項之鞋類物件，其中進一步包含一種鞋內底，鞋內底固定於鞋底，且延伸過腳後跟區及足弓區提供腳後跟區及足弓區需要的硬度。

14. 如申請專利範圍第 13 項之鞋類物件，其中鞋內底由聚合物材料製成。

15. 如申請專利範圍第 14 項之鞋類物件，其中進一步包含位在鞋內底上方的鞋墊，鞋墊由有彈性的材料製成提供鞋類物件需要的緩衝力。

16. 如申請專利範圍第 15 項之鞋類物件，其中鞋墊可移動的

(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

訂

線

六、申請專利範圍

固定於鞋內底上。

17. 如申請專利範圍第 12 項之鞋類物件，其中接縫平行穿戴者腳部底線延伸。

18. 一種製造具有包裹結構之鞋類物件的製造方法，其包含步驟：

形成一具有沿其周圍延伸縫合處的鞋面；

形成一具有沿其周圍延伸縫合處的鞋底；

固定鞋外底至鞋底，鞋外底有腳後跟及前腳部份，腳後跟部份在足弓區與前腳區分隔，藉以鞋底至少延伸至足弓區；且

沿水平接縫縫合鞋底及鞋面，此接縫結合鞋面縫合處及鞋底縫合處，該接縫實質位於前腳區與腳後跟區的上方且與此二區分隔開來。

19. 如申請專利範圍第 18 項之製造方法，其中進一步包含步驟：

鞋面及鞋底縫合步驟後打樣；且

當鞋面及鞋底在打樣時，由熱結合鞋面及鞋底。

20. 如申請專利範圍第 19 項之製造方法，其中縫合步驟包含的步驟：

在前腳區縫合向外翻轉縫合處；

在足弓區縫合向內翻轉縫合處；且

在腳後跟區縫合向外翻轉縫合處。

21. 如申請專利範圍第 20 項之製造方法，其中進一步包含以黏合至少前腳區向外翻轉縫合處及腳後跟區向外翻轉縫合

六、申請專利範圍

處結合鞋面縫合處及鞋底縫合處的步驟。

22. 如申請專利範圍第 21 項之製造方法，其中縫合步驟包含形成接縫平行延伸至穿戴者腳部底線。

23. 如申請專利範圍第 22 項之製造方法，其中固定步驟包含黏著固定前腳部份及腳後跟部份至鞋底。

24. 如申請專利範圍第 23 項之製造方法，其中進一步包含安置鞋內底至鞋底頂端的步驟，鞋內底延伸過腳後跟區及足弓區中止於穿戴者腳部球狀物直線。

25. 如申請專利範圍第 24 項之製造方法，其中鞋內底由堅硬的材料製造，藉以使鞋內底在允許穿戴者腳部球狀物直線的前腳區伸縮時，提供鞋底需要的堅硬層於腳後跟區及足弓區。

26. 如申請專利範圍第 25 項之製造方法，其中進一步包含安置鞋墊製鞋內底頂端的步驟，鞋墊延伸過腳後跟區，足弓區及前腳區，鞋墊由彈性材料製造以提供需要的緩衝度。

27. 一種製造具有包裹結構之鞋類物件的製造方法，其包含步驟：

形成一具有周圍縫合處的鞋面；

形成一具有周圍縫合處的鞋底；

在前腳區向外翻轉縫合處縫合鞋面縫合處至鞋底縫合處，前腳縫合處水平延伸；

在足弓區向外翻轉縫合處縫合鞋面縫合處至鞋底縫合處，足弓縫合處水平延伸；

在腳後跟區向外翻轉縫合處縫合鞋面縫合處至鞋底縫合

六、申請專利範圍

處，腳後跟縫合處水平延伸；

黏合鞋外底至鞋底，鞋外底包含腳後跟部份及前腳部份，在足弓區延伸至至少為足弓區的鞋底分隔腳後跟部份及前腳部份。

28.如申請專利範圍第 27 項之製造方法，其中進一步包含以黏合至少前腳區縫合處及腳後跟區縫合處結合鞋面縫合處及鞋底縫合處的步驟。

29.如申請專利範圍第 28 項之製造方法，其中前腳區縫合處，足弓區縫合處及腳後跟區縫合處平行穿戴者腳部底線延伸。

30.如申請專利範圍第 29 項之製造方法，其中進一步包含步驟：

鞋面及鞋底縫合步驟後打樣；且

當鞋面及鞋底在打樣，由熱結合鞋面及鞋底。

31.如申請專利範圍第 30 項之製造方法，其中鞋外底接合步驟包含黏合固定前腳部份與腳後跟部份至鞋底。

32.如申請專利範圍第 31 項之製造方法，其中進一步包含安置鞋內底至鞋底頂端的步驟，鞋內底延伸過腳後跟區及足弓區中止於穿戴者腳部球狀物直線。

33.如申請專利範圍第 32 項之製造方法，其中進一步包含安置鞋墊製鞋內底頂端的步驟，鞋墊延伸過腳後跟區，足弓區及前腳區，鞋墊由彈性材料製造以提供需要的緩衝度。